

2026 電子零組件暨顯示器產業年鑑

2026 Electronic Components and Flat Panel Display Industry Yearbook

主編 | 蕭睿中

委託單位：經濟部產業技術司
執行單位：財團法人工業技術研究院
產業科技國際策略發展所

中 華 民 國 一 一 五 年 七 月

序

2025 年臺灣電子零組件產業面臨美國關稅政策、地緣政治與匯率波動等多種不確定因素之挑戰。然而，在 AI 相關應用需求持續擴大的支撐下，帶動產品規格加速升級，成為推動產業成長的關鍵動能，也促使 2025 年臺灣電子零組件暨顯示器產業持續維持成長態勢，表現相對亮眼。

2026 年臺灣整體電子零組件市場預期將受惠於 AI 相關應用持續擴張，帶動產品規格加速升級，並推升高階產品的市場需求，成為推動產業成長的關鍵動能。不過，手機與 PC 等終端應用受產品使用週期延長與產能排擠效應等因素影響，消費電子市場仍面臨不確定性。整體而言，2026 年電子零組件暨顯示器產業產值可望延續成長態勢。

《2026 電子零組件暨顯示器產業年鑑》為工研院產業科技國際策略發展所(產科國際所)執行經濟部產業技術司「產業技術基磐研究與知識服務計畫」之成果。本年鑑由本所電子與系統組同仁負責規劃與編撰，內容詳實記錄 2024~2028 年電子零組件產業中技術與市場之動態及預測，除涵蓋我國與全球電子零組件產業趨勢外，亦針對我國業者如何在全球產業鏈分工中進行有效布局作詳盡的分析。

在此謹向經濟部產業技術司長期以來的支持與鼓勵表達誠摯感謝，並向撰稿作者深表謝忱。本年鑑承蒙各界讀者的肯定與支持，然編撰過程中難免仍有疏漏與未盡周延之處，尚祈各界先進賢達不吝指教，惠賜寶貴建言，俾作為未來精進與改進之參考。

工業技術研究院
產業科技國際策略發展所
所長

紀昭吟

編者的話

「2026 電子零組件暨顯示器產業年鑑」記錄臺灣與全球電子零組件和顯示器產業發展軌跡，今年增加散熱模組產業進行觀測，除了分析過去一年來我國及主要工業國家電子零組件和顯示器產業發展現況與趨勢外，亦增加關鍵議題探討、產品技術趨勢分析以及產業 AI 應用分析，提供業者近期發展之關鍵議題與未來產品開發方向之參考。

全文內容共分成七篇，第一篇至第二篇主要由總體環境之統計圖表、整體市場等構面來探討產業整體之發展；第三篇為關鍵議題探討，主要從三個關鍵議題去探討：1.AI 應用擴展下：臺灣電子零組件的價值鏈重組與自主化發展策略、2.高速傳輸零組件新生態：矽光子技術對臺灣供應鏈的影響與 3.策略以及智慧製造與工業機器人時代：零組件功能升級與臺灣的切入策略；第四篇為全球產業個論；第五篇為我國產業個論，從產業概述、產業結構、產業聚落、產業發展現況與趨勢等面向進行電子零組件和顯示器產業市場分析，並進一步觀察未來市場展望；第六篇為未來展望篇；針對全球與我國產業展望做一摘要與歸納；第七篇為附錄篇，主要收錄國內外電子零組件和顯示器產業大事紀、廠商、公協會基本資料等。

本年鑑執行期間承蒙各業界專家及本院產科國際所各級主管費心審閱，才得以順利出版，在此致上十二萬分感謝。同時本年鑑於資料收集、整理撰寫、付梓過程中，難免有些許誤差之處，尚祈各界先進不吝賜正指教，以作為未來改進之參考。

工業技術研究院
產業科技國際策略發展所
電子零組件研究部

蕭睿中

2026 電子零組件暨顯示器產業年鑑

撰稿單位暨撰稿人

撰稿單位	撰稿人	職 稱
工研院產科國際所	蕭睿中	產業分析師
工研院產科國際所	張淵崧	產業分析師
工研院產科國際所	張宏毅	產業分析師
工研院產科國際所	陳昱橙	產業分析師
工研院產科國際所	陳祉妤	產業分析師
工研院產科國際所	呂學隆	資深產業分析師
工研院產科國際所	練惠玉	研究助理
工研院產科國際所	洪迎嘉	研究助理
工研院電光系統所	黃奕翔	研發副組長

2026 電子零組件暨顯示器產業年鑑

目 錄

序	0-2
編者的話	0-3
作者群	0-4
目 錄	0-5
圖目錄	0-9
表目錄	0-12

第 I 篇 總體經濟關聯指標

第一章 總體經濟指標	1-1
一、全球經濟成長率	1-1
二、全球消費者物價年增率CPI	1-2
三、主要國家國內生產毛額(以當期價格計)	1-3
四、主要國家國際收支經常帳	1-4
五、主要國家政府財政收入及債務餘額	1-5
六、主要地區出口貿易量成長率	1-6
七、主要地區進口貿易量成長率	1-6
八、主要國家失業率	1-7
九、主要國家投資占GDP比重	1-7
十、主要國家貨幣對美元均價	1-8
十一、臺灣總體經濟指標	1-9

第 II 篇 電子零組件產業總覽

第一章 全球終端產業總覽	2-1
第一節 全球終端市場成長預測	2-1
第二節 全球終端市場未來發展動向	2-9
第二章 全球產業總覽	2-18
一、市場成長預測	2-18

二、未來發展動向	2-25
第三章 我國產業總覽.....	2-30
一、產業特性.....	2-30
二、產業發展歷程	2-33
三、研發人數.....	2-36
四、就業人數.....	2-38
五、我國產業之全球地位.....	2-40
六、市場成長預測	2-41
七、未來發展動向	2-48

第 III 篇 關鍵議題探討

第一章 國家政策聚焦產業	3-1
第二章 重大議題影響分析	3-5
第一節 AI應用擴展下：臺灣電子零組件的價值鏈重組與自主化 發展策略	3-5
第二節 高速傳輸零組件新生態：矽光子技術對臺灣供應鏈的 影響與策略.....	3-11
第三節 智慧製造與工業機器人時代：零組件功能升級與臺灣的 切入策略	3-15
第三章 新興產品技術趨勢	3-19
第一節 CoWoP：AI晶片封裝的新技術路徑.....	3-19
第二節 新興液冷技術發展趨勢解析.....	3-23
第三節 資訊浮在路上不是科幻-3D AR-HUD背後的顯示科技 新突破	3-29
第四章 產業AI應用分析	3-49
第一節 前言：電子零組件暨顯示器產業AI應用概述.....	3-49
第二節 各領域AI應用	3-51
第三節 AI在電子零組件產業未來發展趨勢	3-55

第Ⅳ篇 全球電子零組件產業個論

第一章 全球暨主要國家	4-1
第一節 電路板產業	4-1
第二節 被動元件產業	4-7
第三節 能源元件產業	4-12
第四節 感測元件產業	4-21
第五節 顯示器產業	4-28
第六節 散熱模組產業	4-36
第二章 新南向國家	4-41

第Ⅴ篇 我國電子零組件產業個論

第一章 電路板產業	5-1
第一節 產業概述	5-1
第二節 產業發展現況與趨勢	5-3
第三節 產業聚落	5-10
第二章 被動元件產業	5-16
第一節 產業概述	5-16
第二節 產業發展現況與趨勢	5-17
第三節 產業聚落	5-25
第三章 能源元件產業	5-29
第一節 產業概述	5-29
第二節 產業發展現況與趨勢	5-31
第三節 產業聚落	5-38
第四章 感測元件產業	5-43
第一節 產業概述	5-43
第二節 產業發展現況與趨勢	5-45
第三節 產業聚落	5-51

第五章 顯示器產業	5-55
第一節 產業概述	5-55
第二節 產業發展現況與趨勢	5-60
第三節 產業聚落	5-69
第六章 散熱模組產業	5-77
第一節 產業概述	5-77
第二節 產業發展現況與趨勢	5-79
第三節 產業聚落	5-85

第VI篇 未來展望

第一章 全球產業展望	6-1
一、2026年市場預測	6-1
二、產業發展趨勢	6-5
第二章 我國產業展望	6-9
一、2026年市場預測	6-9
二、產業發展趨勢	6-13

附 錄

附錄一 2025年電子零組件產業大事紀	7-1
附錄二 電子零組件產業廠商名錄	7-16
附錄三 電子零組件與顯示器相關產業協會	7-36
附錄四 2026電子零組件相關展覽時程	7-38
附錄五 中英文專有名詞縮語/略語對照表	7-40

圖目錄

圖2-3-1	臺灣電路板產業發展歷程	2-33
圖2-3-2	臺灣被動元件產業發展歷程	2-33
圖2-3-3	臺灣能源元件產業發展歷程	2-34
圖2-3-4	臺灣感測元件產業發展歷程	2-34
圖2-3-5	我國平面顯示器面板產業發展歷程 (包含大型與中小型TFT LCD面板和OLED面板).....	2-35
圖2-3-6	臺灣散熱模組產業發展歷程	2-35
圖3-3-1	CoWoP疊構示意圖	3-20
圖3-3-2	資料中心液冷散熱系統	3-23
圖3-3-3	(上圖)採用熱介面材料、上蓋及冷板配置的CoWoS方案 (下圖)採用IMC-Si散熱的CoWoS方案.....	3-25
圖3-3-4	駕駛視角概念圖：多深度AR標記錨定在真實場景上	3-29
圖3-3-5	HUD演進五階段	3-32
圖3-3-6	HUD市場趨勢	3-34
圖3-3-7	工研院提出新一代融合P-HUD/3D AR-HUD構想	3-35
圖3-3-8	光場、視差、真實世界：眼睛行為三聯圖	3-38
圖3-3-9	工研院展示連續景深3D AR-HUD技術	3-44
圖4-1-1	2024~2028年全球電路板市場規模趨勢	4-1
圖4-1-2	2024~2028年日本電路板產值規模趨勢	4-2
圖4-1-3	2024~2028年中國大陸電路板產值規模趨勢	4-3
圖4-1-4	2024~2028年全球被動元件市場規模趨勢	4-7
圖4-1-5	2024~2028年日本被動元件產值規模趨勢	4-8
圖4-1-6	2024~2028年全球能源元件市場規模趨勢	4-12
圖4-1-7	2024~2028年日本能源元件市場規模趨勢	4-14
圖4-1-8	2024~2028年韓國能源元件市場規模趨勢	4-15
圖4-1-9	2024~2028年中國大陸能源元件市場規模趨勢.....	4-17
圖4-1-10	2024~2028年全球感測元件市場規模趨勢	4-21

圖4-1-11	2024~2028年全球大型TFT LCD市場規模趨勢	4-28
圖4-1-12	2024~2028年全球中小型TFT LCD市場規模趨勢	4-29
圖4-1-13	2024~2028年全球OLED市場規模趨勢	4-31
圖4-1-14	2024~2028全球散熱模組市場規模趨勢	4-36
圖5-1-1	臺灣電路板產業概況	5-1
圖5-1-2	臺灣電路板產業發展歷程	5-3
圖5-1-3	臺灣電路板產業結構	5-5
圖5-1-4	2024~2028年臺灣電路板產值趨勢	5-6
圖5-1-5	2022~2026年臺灣電路板進出口趨勢	5-8
圖5-1-6	2025年臺灣電路板主要進出口國比重	5-9
圖5-1-7	臺灣電路板產業區域聚落現況	5-10
圖5-1-8	臺灣電路板產業鏈	5-11
圖5-2-1	臺灣被動元件產業概況	5-16
圖5-2-2	臺灣被動元件產業發展歷程	5-17
圖5-2-3	臺灣被動元件產業結構	5-20
圖5-2-4	2024~2028年臺灣被動元件產值趨勢	5-21
圖5-2-5	2022~2026年臺灣被動元件進出口趨勢	5-22
圖5-2-6	2025年臺灣被動元件主要進出口國比重	5-23
圖5-2-7	臺灣被動元件產業區域聚落現況	5-25
圖5-2-8	臺灣被動元件產業鏈	5-26
圖5-3-1	臺灣能源元件產業概況	5-29
圖5-3-2	臺灣能源元件產業發展歷程	5-31
圖5-3-3	臺灣能源元件產業結構	5-33
圖5-3-4	2024~2028年臺灣能源元件市場趨勢	5-34
圖5-3-5	2022~2026年臺灣能源元件進出口趨勢	5-36
圖5-3-6	2025年臺灣能源元件主要進出口國	5-37
圖5-3-7	臺灣能源元件產業區域聚落現況	5-38
圖5-3-8	臺灣能源元件產業鏈	5-39
圖5-4-1	臺灣感測元件產業概況	5-43

圖5-4-2	臺灣感測元件產業發展歷程	5-45
圖5-4-3	臺灣感測元件產業結構	5-47
圖5-4-4	2024~2028年臺灣感測元件產值趨勢	5-49
圖5-4-5	臺灣感測元件產業區域聚落現況	5-51
圖5-4-6	臺灣感測元件產業鏈	5-52
圖5-5-1	我國平面顯示器面板產業發展歷程 (包含大型與中小型TFT LCD和OLED面板)	5-55
圖5-5-2	臺灣大型TFT LCD產業概況	5-56
圖5-5-3	臺灣中小型TFT LCD產業概況	5-57
圖5-5-4	臺灣OLED產業概況	5-58
圖5-5-5	臺灣TFT LCD產業結構	5-60
圖5-5-6	臺灣OLED產業結構	5-62
圖5-5-7	2024~2028年臺灣大型TFT LCD產值趨勢	5-63
圖5-5-8	2024~2028年臺灣中小型TFT LCD產值趨勢	5-65
圖5-5-9	2024~2028年臺灣OLED產值趨勢	5-66
圖5-5-10	2022~2026年臺灣顯示器進出口趨勢	5-67
圖5-5-11	2025年臺灣顯示器主要進出口國分析	5-68
圖5-5-12	臺灣顯示器產業區域聚落現況	5-69
圖5-5-13	臺灣顯示器產業鏈	5-70
圖5-6-1	臺灣散熱模組產業概況	5-77
圖5-6-2	臺灣散熱模組產業發展歷程	5-79
圖5-6-3	臺灣散熱模組產業結構	5-80
圖5-6-4	2024~2028年散熱模組產值趨勢	5-81
圖5-6-5	2022~2026年臺灣散熱模組進出口趨勢	5-82
圖5-6-6	2025年臺灣散熱模組主要進出口國比重	5-84
圖5-6-7	臺灣散熱模組產業區域聚落現況	5-85
圖5-6-8	臺灣散熱模組產業鏈	5-86

表目錄

表3-1-1	五大信賴產業連結	3-2
表3-3-1	規格面比較(光學與AR對位能力).....	3-39
表3-3-2	人因面比較(駕駛長時間使用的真實負擔).....	3-40
表3-3-3	規格表-ITRI立體連續景深3D AR-HUD.....	3-45
表4-1-1	全球主要電路板廠商發展動向與策略分析	4-4
表4-1-2	全球被動元件產業主要廠商發展動向與策略分析.....	4-9
表4-1-3	全球能源元件產業主要廠商發展動向與策略分析.....	4-18
表4-1-4	全球感測元件產業主要廠商發展動向與策略分析.....	4-23
表4-1-5	全球顯示器產業主要廠商發展動向與策略分析.....	4-32
表4-1-6	全球主要散熱模組廠商發展動向與策略分析	4-39
表4-2-1	2025年新南向國家電子零組件暨顯示器產業當地產業政策 與需求	4-41
表4-2-2	2025年新南向國家電子零組件暨顯示器產業臺商能量 與競爭者分析.....	4-51
表4-2-3	2025年新南向國家電子零組件暨顯示器產業臺商優劣勢 與機會分析.....	4-56
表5-1-1	臺灣電路板產業區域聚落特性與規模.....	5-12
表5-1-2	臺灣電路板產業區域聚落發展課題與可行方案.....	5-14
表5-2-1	臺灣被動元件產業區域聚落特性與規模.....	5-27
表5-2-2	臺灣被動元件產業區域聚落發展課題與可行方案.....	5-28
表5-3-1	臺灣能源元件產業區域聚落特性與規模.....	5-40
表5-3-2	臺灣能源元件產業區域聚落發展課題與可行方案.....	5-41
表5-4-1	臺灣感測元件產業區域聚落特性與規模.....	5-53
表5-5-1	臺灣顯示器產業區域聚落特性與規模.....	5-72
表5-5-2	臺灣顯示器產業區域聚落發展課題與可行方案.....	5-74
表5-6-1	臺灣散熱模組產業區域聚落特性與規模.....	5-87
表5-6-2	臺灣散熱模組產業區域聚落發展課題與可行方案.....	5-88
表6-1-1	全球電子零組件產業暨顯示器市場預測	6-1

表6-1-2	全球電子零組件暨顯示器產業發展趨勢	6-5
表6-2-1	我國電子零組件產業市場預測	6-9
表6-2-2	我國電子零組件暨顯示器產業發展趨勢	6-13



2026 Electronic Components and Flat Panel Display Industry Yearbook

Contents

Preface	0-2
Editor's Words	0-3
List of Authors	0-4
Table of Contents	0-5
List of Figures	0-9
List of Tables	0-12

Part I Overall Economic Indicators

Chapter 1 Major Indexes of Overall Economy	1-1
--	-----

Part II Overview of the Industry

Chapter 1 Overview of the Global ICT Product Market	2-1
Chapter 2 Global Industry Trends	2-18
Chapter 3 Taiwan Industry Trends	2-30

Part III Development Trends of Emerging Topic

Chapter 1 National Policy Focusing Industries	3-1
Chapter 2 Impact Analysis of Major Industry Issues	3-5
Chapter 3 Emerging Product and Technology Trends	3-19
Chapter 4 Analysis of Industrial Applications of AI	3-49

Part IV Global Industry Development

Chapter 1 Global and Major Countries	4-1
Chapter 2 New Southbound Countries	4-41

Part V Taiwan Industry Development

Chapter 1 Printed Circuit Board Industry	5-1
Chapter 2 Passive Components Industry	5-16
Chapter 3 Battery Industry	5-29
Chapter 4 Sensor Module Industry	5-43
Chapter 5 Display Industry	5-55
Chapter 6 Cooling Module Industry	5-77

Part VI Future Outlook

Chapter 1 Global Industry Outlook	6-1
Chapter 2 Taiwan Industry Outlook	6-9

Appendix

Appendix 1 Industry Events in 2025	7-1
Appendix 2 Vendors List	7-16
Appendix 3 Association	7-36
Appendix 4 Exhibition in 2026	7-38
Appendix 5 Proper Noun and Abbreviation	7-40

第一章 國家政策聚焦產業

在全球地緣政治風險日益升高的背景下，臺灣正面臨地緣政治變化、產業供應鏈重組、數位及淨零雙軸轉型的挑戰與轉折，在此環境下必須提升我國實力。為站穩全球供應鏈的關鍵地位，把握地緣政治變化帶來的商機，我國政府提出「五大信賴產業」的政策方向，涵蓋半導體、AI、軍工、安控與次世代通訊，期望透過強化自主技術、深化國際夥伴關係以及提升產業韌性，建構出具全球競爭力的戰略供應體系。

將透過發展半導體、人工智慧(AI)、軍工、安控、次世代通訊等五大產業，打造臺灣成為全球民主科技陣營中不可或缺且受信賴的夥伴，並透過創新驅動，帶動百工百業發展，同時強化國家安全及韌性，促使臺灣成為經濟日不落國，推動策略方向說明如下。

在半導體產業方面，強調強化 IC 設計與先進製程的主導力，並積極推動異質整合封裝技術如 2.5D/3D IC 封裝技術，我國零組件產業積極鏈結新興應用趨勢，如電路板與被動元件與先進封裝(如：CoWoS)等技術結合，同時，透過發展高階材料與設備自製能力，建立國產化供應鏈，讓臺灣從單一製造重鎮進一步向全供應鏈主導者邁進，進一步穩固臺灣在全球半導體產業鏈的不可取代地位。

在 AI 產業方面，政府透過 AI 技術導入資安認證機制，強化社會整體資安韌性，並擴大資安市場規模。並進一步推動跨域聯防計畫，促成資安業者與半導體、通訊及醫療設備廠商協作，開發高度整合的資安模組與韌體防護產品，應用於 5G 與 AIoT 等智慧場域。相關產品除通過國家指定第三方資安檢測外，亦成功導入 5G 智慧工廠、遠距醫療系統與關鍵基礎設施，建構技術導入與應用驗證並行的合作機制，推動本土資安解決方案出口，邁向「可信賴 AI 應用國家」之目標。

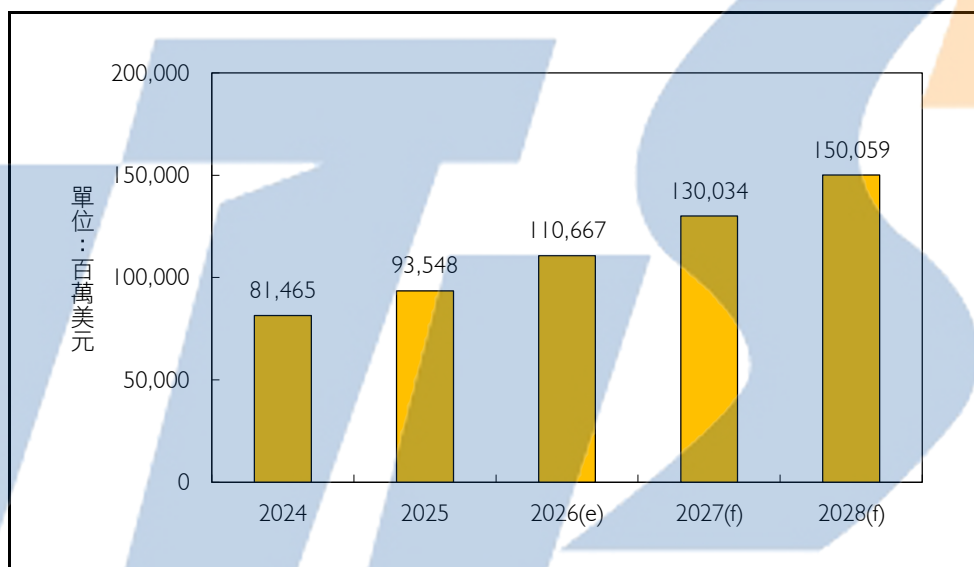
在軍工產業方面，以打造國防產業自主能量與量能為目標，打造無人機非紅供應鏈，目標成為亞太第一；建立發動機鍛件之恆溫鍛造產線，並掌握航太關鍵材料能量，以建立國艦國造自主能量。

第一章 全球暨主要國家

第一節 電路板產業

一、產業發展現況與趨勢

(一) 全球五年市場統計



註：產值包含 PCB 代工及 SMT 產值

資料來源：工研院產科國際所(2026/07)

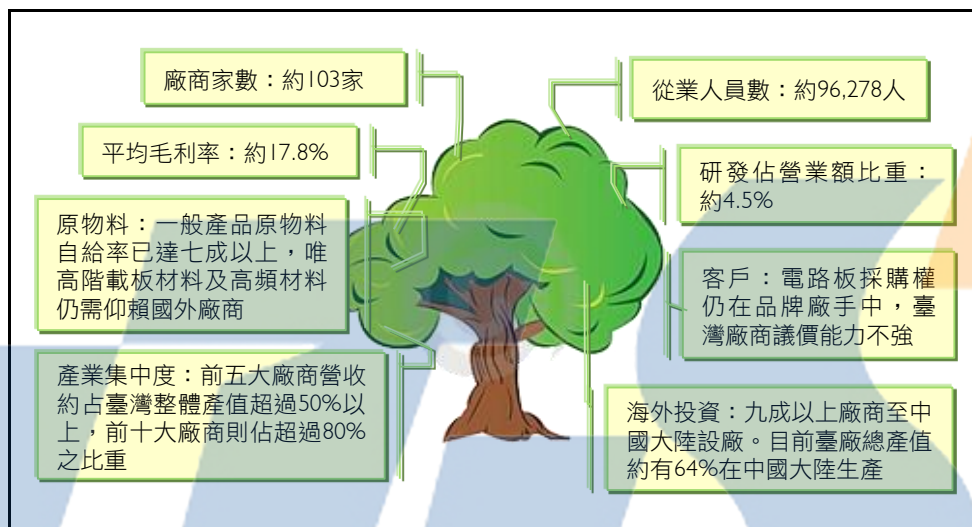
圖 4-1-1 2024~2028 年全球電路板市場規模趨勢

說明：

- 2025 年全球 PCB 產業產值年增 14.8%，市場規模達 935.5 億美元，創歷史新高。主要受惠於 AI 基礎建設需求快速成長，帶動 PCB 朝高層數、高頻高速與高階材料方向升級，產業呈現「價量齊揚」的成長格局。
- 展望 2026 年，AI 基礎建設已成為推動全球 PCB 產業成長的核心動能，相關需求亦由單一 AI 伺服器逐步擴展至整體資料中心架構升級，包括高速

第一章 電路板產業

第一節 產業概述



資料來源：工研院產科國際所(2026/07)

圖 5-1-1 臺灣電路板產業概況

說明：

- 廠商家數與從業人數：2025 年我國電路板廠商約 103 家左右，國內從業人員約為 96,278 人左右。
- 平均毛利率與研發密度：2025 年臺灣電路板產業平均毛利率約 17.8%，較 2024 年提升 0.8 個百分點，主要受惠於 AI 伺服器、HPC 及高階網通設備等應用需求成長，帶動高階 PCB 與載板產品出貨比重提升。在研發投入方面，產業平均研發費用占營收比重達 4.5%，顯示業者持續加碼高頻高速、HDI、高多層板及高階載板等技術開發，以因應市場對高效能電子產品日益提升的技術需求。
- 原物料掌握度：臺灣 PCB 產業鏈發展成熟，上游材料供應體系完整，包括銅箔基板、玻纖布、銅箔、乾膜等關鍵材料多已具備自主供應能力，目

第一章 全球產業展望

一、2026 年市場預測

表 6-1-1 全球電子零組件產業暨顯示器市場預測

單位：百萬美元；%

產業別	2025	2026(e)	2026(e)成長率
總體產業	448,867	494,492	10.2%
電路板	93,548	110,667	18.3%
被動元件	48,754	56,213	15.3%
能源元件	18,878	19,256	2%
感測元件	146,201	157,754	7.9%
大型 TFT LCD	64,115	61,885	-3.5%
中小型 TFT LCD	17,315	16,983	-1.9%
OLED	43,515	44,512	2.3%
散熱模組	16,541	27,222	64.6%

資料來源：工研院產科國際所(2026/07)

說明：

1. 電路板產業

- 2025 年全球 PCB 產業產值年增 14.8%，市場規模達 935.5 億美元，創歷史新高。主要受惠於 AI 基礎建設需求快速成長，帶動 PCB 朝高層數、高頻高速與高階材料方向升級，產業呈現「價量齊揚」的成長格局。
- 展望 2026 年，AI 基礎建設已成為推動全球 PCB 產業成長的核心動能，相關需求亦由單一 AI 伺服器逐步擴展至整體資料中心架構升級，包括高速交換器、光通訊設備、電源系統及先進封裝等領域皆同步受惠，帶動 PCB 產品持續朝高層數、高頻高速及高附加價值方向發展。隨著 AI 基礎建設投資持續擴大，高階 PCB、載板及關鍵材料供給趨於緊張，

書 名：2026電子零組件暨顯示器產業年鑑

出版單位：財團法人工業技術研究院產業科技國際策略發展所

作 者：蕭睿中、張淵崧、張宏毅、陳昱橙、陳祉妤、呂學隆、練惠玉、
洪迎嘉、黃奕翔

出版日期：中華民國115年7月

版 次：初版

售 價：新臺幣10,000元整

展 售 處：工研院產科國際所/新竹縣竹東鎮中興路四段195號10館

IEK產業情報網/<https://ieknet.iek.org.tw/>

ITIS智網/<https://www.itis.org.tw>

E I S B N：978-986-264-456-0

著作權利管理資訊：財團法人工業技術研究院產業科技國際策略發展所保有所有權利。欲利用本書全部或部分內容者，須徵求出版單位同意或書面授權。聯絡資訊：工研院產科國際所 電話：03-5912340

著作權所有，請勿翻印，轉載或引用需經本單位同意